

# 超微細回路形成

## Ultra-fine Pattern Formation

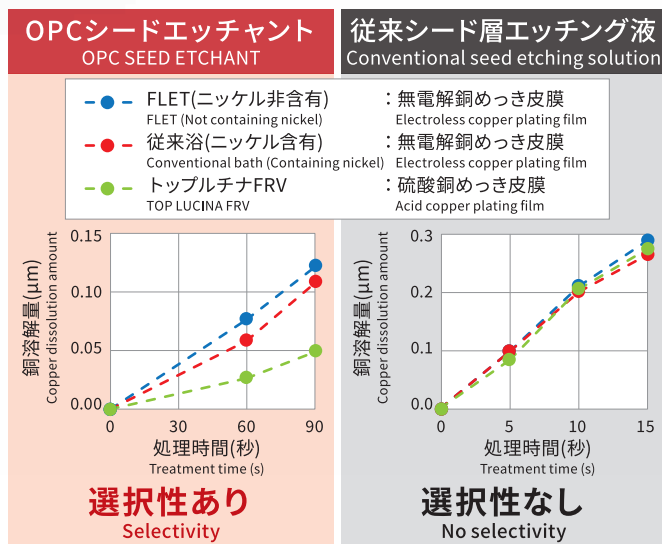
### L/S=1/1 $\mu$ m達成

can be realized



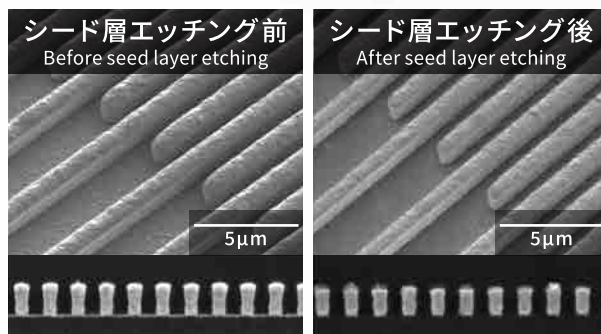
### フラッシュエッチング Flash Etching

- 無電解銅めっき皮膜の選択除去性に優れる  
Can remove copper finely



### OPCシードエッチャント OPC SEED ETCHANT

- パラジウム除去性に優れる  
Can remove palladium residues finely

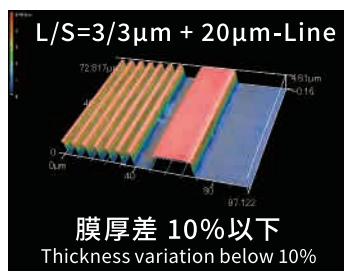


**回路細りなし**  
No damage to fine pattern

**アンダーカットなし**  
No occurrence of undercut

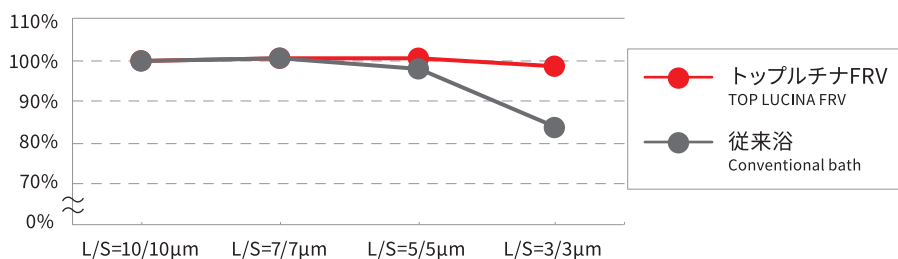
### 硫酸銅めっき Acid Copper Plating

- めっき膜厚均一性に優れる  
Uniform thickness is available



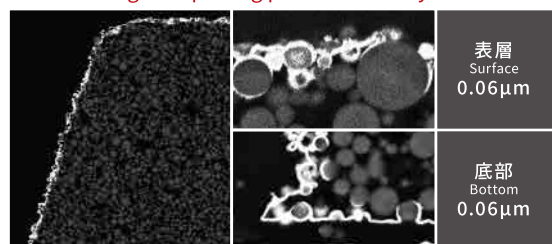
### トップルチナFRV TOP LUCINA FRV

- 微小ブラインドビアホールのフィリングが可能  
Micro-via filling is possible



### デスマア・無電解銅めっき De-smear/Electroless Copper Plating

- 接続信頼性に優れる  
Excellent in connecting reliability
- 低膜厚で優れたビア内のめっき析出性が得られる  
Realize high via plating performance by thin thickness



スローイングパワー : 100%  
Throwing power

### OPC FLETプロセス OPC FLET PROCESS

- 低粗度材料でも高いピール強度  
High peel strength to low Ra material
- 低膜厚でも低いシート抵抗値を示す  
Low sheet resistance by thin thickness

